

Kyocera IR Day
(2022年11月25日実施)

代表取締役社長 谷本 秀夫 スピーチ

<P1. 本日の説明内容>

本日は私より、京セラグループ全体の業績目標及び戦略についてご説明した後、各セグメントの取り組みについて担当役員よりご説明させていただきます。

<P2. 京セラグループ業績目標>

京セラグループの業績目標です。私が社長に就任以来目標としていた売上高2兆円は、2023年3月期(今期)に達成を予想していますが、その次の目標として掲げている売上高3兆円、税引前利益率20%、ROE10%以上については、2029年3月期までに達成したいと考えています。

<P3. 業績目標達成に向けた経営戦略>

業績目標の達成に向けて、こちらに記載の2点について重点的に取り組んでまいります。

1点目は売上の拡大です。最先端半導体や5Gをはじめとする通信関連、モビリティなど、当社が得意とする分野及び高い成長性が見込まれる領域に対して、積極的に投資を進めることで売上の拡大を図ります。

2点目は収益性の向上です。収益性が低い事業だけでなく、高収益な事業においても経営陣主導によるレビューを徹底し、さらなる収益性の向上を進めると同時に、課題事業においては抜本的改革に取り組んでいます。

<P4. 注力分野における積極投資(1)>

注力分野における積極投資についてご説明します。当社は引き続き、高成長が見込まれる市場や製品に向けて集中投資を実施してまいります。

こちらのグラフは、設備投資額と研究開発費の推移です。左端は、2014年3月期から2018年3月期までの5年間の平均です。当期間に1,200億円の水準であった投資額は、2022年3月期(前期)には約2倍となりました。今期はさらに拡大し、過去最高となる約3,000億円を計画しています。2024年3月期(来期)以降も高シェア及び高付加価値製品への優先的な設備投資や新事業創造に向けた研究開発の促進を計画しており、当面、高水準な投資が続くものと考えています。

<P5. 注力分野における積極投資(2)>

今後の設備投資計画についてご説明します。スライド左側のグラフは、ロジック及びメモリー半導体の市場見通しです。足元では旧世代品の充足感から、一時的に需要の調整が見られるものの、2030年にかけては最先端品を中心に、ロジックは年平均約11%、メモリーは同約

5%の堅調な成長が見込まれています。

このような高需要を着実に収益につなげるため、スライドの右側に示します通り、今期から2025年3月期にかけて、国内外において複数の新工場棟の建設を予定しています。主に半導体製造装置用ファインセラミック部品や、セラミック及び有機パッケージなどの増産を計画しています。

<P6. 注力分野における積極投資（3）>

こちらのスライドは、今期及び来期より業績貢献が見込まれる主な研究開発投資の内容及び進捗状況です。当社は、社内外のリソースの活用を通じて様々な社会課題の解決に貢献する製品の開発や事業の創出を強化しています。

低炭素社会の実現に向けては、高効率 GaN レーザーのアプリケーション拡大に取り組んでいます。現在、自動車市場を中心に製品を展開していますが、今期はさらに、通信や医療関連市場への展開を図ります。温室効果ガス排出量の削減に向けては、再生可能エネルギー事業の拡大に取り組んでいます。ソーラーパネルや蓄電池、燃料電池の3電池のラインアップを拡充するとともに、電力サービス分野等、事業領域の拡大を進めています。

また、来期には製造業の人手不足解消に貢献する協働ロボットや、アパレル産業における産業排水の抑制に貢献するインクジェット捺染システムを上市予定です。

<P7. 経営陣主導による事業レビューの強化>

収益性向上に向けた取り組みとして、経営陣主導による事業レビューの強化についてご説明します。当社は、事業利益を基準としたランク分けにより、グループ全体の収益性の底上げを図ります。

スライド左側は、高収益事業に対する取り組みです。

1 点目は生産性の向上です。スマートファクトリーの導入により、工程間の自動搬送による省人化や、情報の一元化及び AI を活用したビッグデータ分析による品質の安定化を目指します。

2 点目は原価高騰への対応です。昨今の世界的なインフレ等によるコストの上昇分を製品価格へ適正に転嫁できるよう、取引先との価格交渉を進めています。

また、3 点目として、デジタル化の推進による全社的な業務効率の向上に取り組んでいます。スライド右側の課題事業については、抜本的な戦略見直し及びモニタリングの強化に取り組んでいます。当社の事業の中には、自部門だけでは課題解決が出来ず、長期にわたり低収益となっている事業や、M&A により獲得した事業で PMI が遅れているものがあります。これらの改善に向けて、マネジメント主導で事業の大幅縮小や他部門との統合、撤退の可能性も含めた施策を検討するとともに、セグメント体制を活用し、全体最適の実現を目指します。

<P8. 業績目標達成に向けたキャピタルアロケーションイメージ>

業績目標の達成に向けた事業の成長・改善に対しては、多額の資金が必要となります。

こちらのスライドは、今後のキャピタルアロケーションのイメージ図です。左側は、今期予想を含む直近3年間の累計です。中央は、来期から2026年3月期までの3年間の累計イメージです。

スライド中央の濃い青のグラフで示している設備投資額は9,000億円程度まで、水色の研究開発費は4,000億円程度まで拡大するものと見込んでいます。また、利益の拡大に伴い、配当金の増加を見込むとともに、さらなる成長に向けて、M&Aによる事業拡大や自社株買いなどの実施も引き続き検討していきます。これらの資金需要に対しては、研究開発費控除前のベースで、1兆4,000~1兆5,000億円規模となる営業キャッシュフローに加え、KDDI株式を担保に5,000億円程度の銀行借入を行うことで対応していく考えです。

来期からの3年間は引き続き事業投資が先行しますが、2027年3月期以降は、その時点の事業の状況、業績目標への進捗状況等を踏まえ、資本配分を改めて検討していきます。

<P9. セグメント別業績目標>

こちらのスライドは連結売上高3兆円、税引前利益率20%達成時の各セグメントの最新の業績目標です。この1年の進捗及び今後の見通しを精査し、前期にご提示したのから更新しています。

「コアコンポーネント」及び「電子部品」は、半導体や5G向けの需要増を反映し、売上高、事業利益ともに増額しています。「ソリューション」は改善に時間を要するものと判断し、売上高、事業利益共に減額しました。

最新の目標として、「コアコンポーネント」は、売上高1兆円、事業利益率24%、「電子部品」は、売上高6,000億円、事業利益率25%、「ソリューション」は売上高1兆4,000億円、事業利益率14%を目指してまいります。

取締役 執行役員常務 コアコンポーネントセグメント担当 触 浩 スピーチ

<P10. (中表紙) 業績目標達成に向けた取り組み(1) コアコンポーネント>

「コアコンポーネント」は、堅調に伸びる半導体関連市場向けに、製造容量拡大に向けた戦略的な設備投資で事業を伸ばしてまいります。また、その成長を支える人材の育成や業務プロセスの効率化にも力を注ぎ、経営基盤の強化を図り、継続的な成長発展を目指してまいります。

<P11. ビジョンと業績目標達成の為の重点施策>

「コアコンポーネント」のビジョンと業績目標達成の為の重点施策についてご説明します。ビジョンは、「持続可能な社会の発展、健康で心豊かな生活のコアとなる製品を提供し、経営理念を実現する」としています。スライド下段に中期的な取組みを示します。

「1. 選択と集中の徹底」では、伸びるアイテムの増産対応、スクラップ&ビルドも考慮しながら、海外拠点の活用を含め生産拠点の整備強化に取り組んでまいります。

「2. 経営基盤の強化」では、今後の継続的な成長を支えるための人材の育成が重要です。また、部門間連携を促進する業務プロセスの整備や効率化にも力を入れてまいります。

<P12. 1. 選択と集中の徹底>

重点施策の1点目は、選択と集中の徹底です。スライド左側に事業別の売上高を示しています。今期通期の売上高見通しは6,000億円ですが、2029年3月期には、今期から66.7%増加の1兆円を目指す計画です。スライド下段の青色で示す半導体関連部品事業では、情報通信向け有機基板及びセラミックパッケージの増産対応、データセンター関連の高付加価値製品に注力します。また、最新設備の導入等により高難度品の生産技術力を向上させます。スライド上段のオレンジ色の産業・車載用部品事業では、好調なロジック系IC等の生産を支える最先端の半導体製造装置用ファインセラミック部品の増産対応、車載カメラやミリ波レーダー基板など車載ADAS関連製品の需要増、EV関連部品等の需要増に対応します。このように情報通信、半導体、車載関連等の伸びる市場を中心に売上を拡大していく計画です。

<P13. 伸びるアイテムでの拡大：半導体関連部品>

半導体関連部品事業についてご説明します。スライド左側のグラフは売上高と事業利益率を示しています。今期予想の売上高3,690億円、事業利益率20.9%から、2029年3月期には、売上高は今期予想から62.6%増加の6,000億円、事業利益率は28%を目指す計画です。スライド右側に課題を示していますが、高付加価値製品の増産対応を積極的に推進します。強みは、有機パッケージ事業における微細配線、高周波対応技術です。半導体市場の成長に合わせ、ハイエンド有機パッケージについては生産容量拡大に向けて新棟を立上げ、最新設備の導入を進めてまいります。京都綾部工場の第3工場では高性能SOC向けの基板を、鹿児島川内工場の新棟では大型高多層FCBGA用パッケージをそれぞれ立ち上げます。加えて、大型高多層品の量産技術力向上に取り組めます。微細配線対応の最新鋭の設備を導入するとともに、培ってきたプロセス技術に加え、自動化や省人化の推進など製造プロセスを磨き上げ、お客様の期待に応えてまいります。

<P14. 伸びるアイテムでの拡大：産業・車載用部品>

産業・車載用部品事業についてご説明します。今期予想の売上高2,020億円、事業利益率14.4%から、2029年3月期には、売上高は今期予想から73.3%増加の3,500億円、事業利益率19%を目指す計画です。スライド右側に記載の通り、最先端の半導体製造装置用部品の増産を積極的に推進します。強みは最先端の半導体製造装置向け特殊部品の加工技術や量産力ですが、市場の要求は既に製造容量を超える状況が続いており、早急にレベルアップさせていくことが必要です。鹿児島国分工場での新棟建設など、生産能力拡大を進めてまいります。また、車載関連でも車載カメラモジュール、ミリ波レーダー基板、統合ECU向け基板などのADAS用途や、絶縁基板やリレーケースなどのEV用途の増産対応を進めます。

<P15. 2. 経営基盤の強化（部門横断プロジェクト活動）>

重点施策の2点目は経営基盤の強化です。現在、好調な半導体関連市場を背景に大きく成長する局面にあります。この成長を支えるためには、経営の基盤となる人材の育成、業務システムの最適化や効率化などが「コアコンポーネント」として極めて重要な課題だと考えてい

ます。部門横断のプロジェクトでこれらの課題に多面的に取り組み、経営基盤を強化してまいります。

スライドの上から順番に、技術推進プロジェクトでは、技術者チームで課題を抱える部門の集中改善に取り組みます。戦略企画プロジェクトでは、市場別調査と我々のコア技術を活かした新規テーマ探索に取り組みます。DX 推進プロジェクトでは、スマートファクトリーや SFA、MA といった製販での DX 推進に取り組みます。HRD 推進プロジェクトでは、様々な教育プログラムでスキルアップやモチベーションの向上を図るとともに、キャリア形成を支援し、次期リーダーの育成に取り組みます。QMS 推進プロジェクトでは、業務プロセスを最適化し、PDCA が適切に回る仕事の仕組み作りをそれぞれ進めています。これらのプロジェクト活動により、人材育成と業務プロセスの両面から経営基盤を強化し、継続的な成長発展を目指してまいります。

取締役 執行役員常務 電子部品セグメント副担当 嘉野 浩市 スピーチ

<P16. (中表紙) 業績目標達成に向けた取り組み (2) 電子部品>

<P17. 伸びる市場へ注力>

「電子部品」は、事業拡大へ向け、伸びる市場へ注力してまいります。

スライド左側のグラフは市場別売上高推移です。今期は売上高 3,800 億円、事業利益率 15.8% を予想しています。2029 年 3 月期には、今期予想比 57.9% 増加の売上高 6,000 億円、事業利益率 25% を目指します。特に注力して伸ばす市場は、スライド右側の図の通り、医療、航空宇宙、データストレージ・IC 関連、産業、車載になります。2029 年 3 月期の注力分野合計の売上高は全体の 65% となり、今期に比べ成長率は 2.1 倍になる見通しです。

この業績目標を達成するために、スライド右下にあります、「1. 競争優位分野への積極投資」、「2. グローバル生産拠点の拡張」、「3. 労働力確保と更なる生産性改善」、「4. 独自技術の開発」の 4 つの施策を実行します。

<P18. 1. 競争優位分野への積極投資>

「競争優位分野への積極投資」についてご説明します。スライド上段の製品面では、タイミングデバイスにおいて、水晶部品はコアとなる社内基礎技術であるフォトリソ、CVM、セラミックパッケージを活用し、更に事業を拡大します。MEMS 部品は次世代発振部品であり、小型、薄型、優れた高温特性を活かし、高付加価値市場へ展開していきます。

タンタルコンデンサは、ベースタンタル事業で約 50% のシェアを確保しており、今後データストレージ等で需要増が見込まれるポリマー製品を拡大します。

MLCC は、今後大きく伸びる次世代 IC 内蔵用に、自社特許を活用して製品開発を進めています。また、KYOCERA AVX Components Corporation (KAVX) が得意とする欧米の航空、宇宙、医療、産業向けの高付加価値製品の拡大を行います。

販売面では、米国代理店との強固な関係を更に活用していきます。KAVX の売上の約 50% が代理店経由であり、同社は代理店向けの販売システムを持ち、米国本社主導で迅速に対応することで長年にわたる信頼関係を築いてきました。京セラ電子部品事業の部品をこのルートに

供給し、売上を拡大します。次に、欧州車載メーカーとの強固な取引関係についてです。「電子部品」の欧州売上の約50%は車載関連です。センサー&コントロール部門がアクセルペダルや温度センサーを車両メーカーと直接取引しており、設計の初期段階より参入が可能です。この関係を活かし、他の部品群を伸べる車載市場へ拡販していきます。これらの競争優位分野に集中投資を行い、強みを活かしてまいります。

<P19. 2. グローバル生産拠点の拡張、3. 労働力確保と更なる生産性改善、4. 独自技術の開発>

2点目の「グローバル生産拠点の拡張」についてご説明します。注力製品の増産、供給体制を構築すると共に、グローバルでの生産の最適地化を行います。スライド下段にありますように、タイ新工場、ベトナム工場、鹿児島国分工場新棟、エルサルバドル工場にて、注力製品であるMLCC、タンタルコンデンサ、水晶部品を増産していきます。

次に、3点目の「労働力確保と更なる生産性改善」についてご説明します。KAVXの強みは、世界の18か国、33拠点に工場を持ち、ローカル社員のみで運営するノウハウを持っていることです。これを活かし、労働力の確保と、地政学を考えた最適サプライチェーンを確立します。加えて、生産工程の自動化による省人化やAI・ロボットでの自動制御による品質の安定性向上を、京セラ電子部品事業の生産技術が担い、グローバル生産拠点へ展開していきます。

4点目の「独自技術の開発」についてご説明します。KAVXの低ESL製品設計力と京セラ電子部品事業の小型薄型MLCC生産技術を活かし、自社特許を活用したIC基板内蔵型MLCCを開発します。また、グループR&D米国拠点を設立します。米国最先端技術のリサーチを、KAVX開発トップがリーダーを兼任で行い、京セラ電子部品事業がハブとなり製品を開発します。Corporate Venture Capitalも設立し、迅速かつローカルで判断できる体制を取っていきます。注力分野は半導体関連、5G・6G、モビリティ、医療、宇宙分野です。

M&A、資本提携については、今期より米国に専門チームを設立しました。元米国半導体投資部門出身の米国人リーダーを中心に、欧米のターゲット企業にアプローチを行っています。欧米の投資関連のソサイエティ・ループに入り、魅力ある投資を行っています。

<ビデオメッセージ：執行役員常務 電子部品セグメント担当 ジョン・サービス>

詳細な戦略や計画は副担当の嘉野よりご説明しましたので、私からは、「電子部品」セグメント最大のチャレンジである、京セラ電子部品事業とKAVXの統合について、現在までの進捗と今後の計画についてご説明させていただきます。

京セラがKAVXを100%子会社化してから2年以上が経過し、この間、両社の統合に向けた計画を進めてきました。統合計画は4年にわたり実施するものです。両社を束ねる「電子部品」セグメントの体制のもと、お互いの長所を活かした統合が順調に進捗しています。

毎四半期、日米両社の幹部によるFace to Faceのミーティングを開催し、各部門でのグローバルな共同戦略の立案やアクションの決定などを通じ、シナジーの最大化に向けて効果が出始めています。具体的には、営業・マーケティング組織においては全地域で両社の統合が完了し、お互いが強みを持つ販路を活用したクロスセル活動などの協働を進めています。

また、MLCC及びコネクタ事業においては、今期より両社を統括する部門をサブセグメントとして新設し、経営リソースの有効活用や効率化に向けた自動化ラインの導入拡大や共同購買

の推進、新製品開発のスピードアップなどに取り組むことが出来ています。

これら製造・販売・開発の統合効果は、来期より本格的に業績に寄与するものと期待しています。さらに人材面では、将来のリーダーの育成に向けて、今期よりトレーニー制度を導入しており、両社間における人材交流の活性化にも取り組んでいます。

足元では景気悪化が懸念されていますが、真にグローバルな「電子部品」セグメントの確立に向け、両社のシナジーを追求し、2029年3月期に売上高6,000億円、事業利益率25%の達成を目指します。

<P20. サマリー>

こちらのスライドは、ジョン・サービスのスピーチをまとめたものです。両社のシナジーを更に追求し、真のグローバルセグメントの実現、及び2029年3月期に売上高6,000億円、事業利益率25%の達成を目指します。

<P21. unity>

Unity、Shifting towards a better tomorrow を合言葉に、真のグローバル企業体を作り上げ、他社とは違う独自の強みを活かし、事業を拡大してまいります。

取締役 執行役員常務 ソリューションセグメント担当 伊奈 憲彦 スピーチ

<P22. (中表紙) 業績目標達成に向けた取り組み (3) ソリューション>

<P23. 業績目標>

業績目標についてご説明します。スライド左側に示します通り、今期は売上高1兆330億円、事業利益率5.2%の見通しです。そして、2029年3月期は、売上高1兆4,000億円、事業利益率14%を目指します。

スライド右側は、「ソリューション」が目指すビジョンです。既存の枠にとらわれずに、社会そしてお客様の課題を解決するソリューションを提供し、さらに人類、社会の進歩発展に貢献するイノベーションの創出を目指します。

<P24. 業績目標達成のための重点施策>

業績目標達成のための重点施策についてご説明します。

1 点目は既存ビジネスの強化です。ドキュメントソリューション事業、機械工具事業についてご説明します。2 点目は低収益・低成長事業の構造改革です。通信機器事業、スマートエネルギー事業についてご説明します。3 点目は、お客様そして社会の課題を解決する新規ビジネスを創出する「ビジネスインテグレーション活動」についてご説明します。

<P25. ① 既存ビジネスの強化>

1 点目の既存ビジネスの強化についてご説明します。まず、スライド左側のドキュメントソリューション事業です。2029年3月期は、売上高6,000億円、事業利益率15%を目指します。

オフィス機器においては環境配慮型製品の強化・拡充を図り、シェアアップと消費電力の大幅な削減による持続可能社会への貢献を図ります。成長が期待される商業用インクジェット、ECM、ドキュメントBPOは、ラインアップ拡充などで事業を成長させます。

スライド右側の機械工具事業については、2029年3月期は、売上高4,000億円、事業利益率15%を目指します。切削工具の重点施策として、EV、半導体、メディカル、航空機の成長産業への新加工技術・製品の開発、また、アジアなど成長市場での現地生産、販売による競争力強化などを推進します。空圧・電動工具は充電プラットフォームの共通化、グローバルでのプロダクトシェア展開を図り、事業拡大、収益アップを図ります。

<P26. ② 低収益・低成長事業の構造改革：通信機器>

2点目の低収益・低成長事業の構造改革についてご説明します。まず、通信機器事業についてご説明します。「JAPAN MADE」を強みとして活かせる市場、高い付加価値を提供できる市場に集中し、高収益事業への転換を図ります。具体的には、「コンシューマーからビジネスユース」へシフトし、機器事業から通信ソリューション事業へ進化させます。

ビジネスユースとして、ビジネス顧客が必要とする「機器、カスタマイズ商品」、「サービス」、さらに、「コネクティングサポート」を強力に提供できるよう改革を進めます。この構造改革のため、京セラグループが保有する通信関連ノウハウを結集し、組織を再編成します。そして、端末から基地局までの5G関連機器、サービスをトータルで提供する通信ソリューション事業へ進化させます。

<P27. ② 低収益・低成長事業の構造改革：スマートエネルギー>

スマートエネルギー事業についてご説明します。同事業を「モノ」売りから「コト」売りへ変革させます。スライド左側に記載の通り、当社が展開する太陽電池、クレイ型蓄電池、燃料電池の3電池事業の強みを活かして、サブスクリプション販売を導入します。利用者は初期コストゼロで導入できます。当社のメリットは販売機会の増大に加え、余剰電力の獲得です。スライド右側の再エネ電力サービスの展開についてご説明します。再エネ需要の増大、電気料金高騰という社会背景から、飛躍的にビジネスの機会が増えていくと予想されます。続いて、当社の事業モデルをご説明します。集合住宅パートナー、自社発電所のほか、サブスクリプション販売展開によって得られる余剰電力など、多様な再エネ電力を調達します。そして、自動的に需給管理ができるシステムを独自に開発します。このように、調達した再エネ電力を独自開発のシステムを介して、自社での使用に加え、RE100など再生可能エネルギーを希望するお客様に環境価値電力として販売します。

これまでの機器販売中心の「モノ」売りから「コト」売りへ事業を変革させることで、社会に貢献し、利益を生み出す価値ある事業に変革させていきます。

<P28. ③お客様、社会の課題を解決する新規ビジネスを創出する「ビジネスインテグレーション活動」>

新規ビジネスを創出する「ビジネスインテグレーション活動」についてご説明します。

これは、プロダクトライン、マーケティングアプローチ、テクニカルアプローチの取り組みを共有し、当社グループ全体で保有しているコンピテンスを既存の枠を超えてインテグレーション

ションすることによって新しい事業の創出を体系的に推進し、チャレンジ・開拓精神を重んじる京セラフィロソフィを実践することを目的に展開しています。

スライド中央に記載の通り、お客様、そして社会の課題解決に繋がる「事業化アイデア」と「関連取り組み」、「保有コンピテンス」、「外部アライアンスの可能性」についての共有・統合を定期的に議論し、新しいビジネスの可能性を探索しています。このような活動をさらに強化し、協働ロボットやインクジェット捺染システムの例のような、お客様、そして社会の課題を解決する新しい事業を数多く創出し、成長させていきたいと考えています。

<P29. ビジョン>

これまで説明しました施策を積極的に進めることで、業績目標の達成とともに、ビジョンの実現を図って参ります。

以上

将来事象に関する注意事項

当資料には、将来の事象についての Kyocera IR Day 開催日（2022年11月25日開催）時点における当社グループの期待、見積り及び予測に基づく記述が含まれています。これらの将来の事象についての記述には、既知及び未知のリスク、不確実な要因並びにその他の要因が内包されており、当社グループの将来における実際の財政状態及び活動状況が、当該将来の事象についての記述によって明示または黙示されているところと大きく異なる場合があります。詳細は、当社ホームページに掲載の「将来の見通しに関する記述等について」をご参照ください (<https://www.kyocera.co.jp/ir/disclaimer.html>)。